

業 務

概覽

我們是中國領先的國產平台化芯片定制服務提供商，專注於AI ASIC的研發和商業化。憑藉我們自主研發的IC技術平台和專有高速接口IP，我們定制的AI ASIC能夠解決數據傳輸瓶頸，實現大規模AI芯片集群的高效互聯，旨在人工智能應用中達到算力利用率的最大化。根據灼識諮詢的資料，按2025年AI ASIC收入計算，我們在中國國產芯片定制服務提供商中排名第三，且按2025年芯片設計及交付收入計算，我們在中國國產芯片定制服務提供商中排名第二。

我們的芯片定制服務

我們的芯片定制服務由芯片設計、芯片交付及IP授權組成。芯片設計涵蓋芯片定義、前端設計、後端設計、流片、硅後支持及客戶產品化賦能。芯片交付涵蓋晶圓級硅片驗證、先進封裝與測試以及供應鏈協同。

芯片定制服務委託可從芯片設計開始（無論是否包含IP授權），並可能隨後進行芯片交付。芯片設計及芯片交付為我們的主要收入來源，於2023年、2024年及2025年的合計收入貢獻分別為83.9%、73.3%及91.0%。

下表載列往績記錄期間按業務線劃分的收入明細。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)					
芯片設計.....	41,259	55.1	231,505	66.6	203,228	42.0
芯片交付.....	21,525	28.8	23,353	6.7	237,597	49.0
IP授權.....	12,018	16.1	92,698	26.7	43,371	9.0
總計	74,802	100.0	347,556	100.0	484,196	100.0

我們的收入由2023年的人民幣74.8百萬元大幅增至2024年的人民幣347.6百萬元，並進一步增加39.3%至2025年的人民幣484.2百萬元。然而，往績記錄期間各業務線的收入波動，乃受任何特定年度的芯片定制服務委託的服務組合及實際進度影響。自2023年至2024年，芯片設計收入及IP授權收入大幅增加，而芯片交付收入增加8.5%，主要是由於多個新項目於2024年完成設計階段，但尚未達到或完成交付階段。自2024年至2025年，芯片交付收入大幅增加，成為2025年最大收入貢獻者，而芯片設計收入及IP授權收入均有所減少，乃主要由於多個現有項目於2025年進入交付階段。

業 務

下表載列往績記錄期間按服務應用類型劃分的收入明細。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	<i>(以千元計，百分比除外)</i>					
AI ASIC	38,658	51.7	314,932	90.6	437,262	90.3
通信ASIC	35,421	47.4	32,624	9.4	46,934	9.7
其他	723	0.9	—	—	—	—
總計	74,802	100.0	347,556	100.0	484,196	100.0

我們的AI ASIC收入由2023年的人民幣38.7百萬元大幅增加至2024年的人民幣314.9百萬元，並進一步增加38.8%至2025年的人民幣437.3百萬元。於2023年、2024年及2025年，我們的AI ASIC收入分別佔我們總收入的51.7%、90.6%及90.3%。於往績記錄期間，AI ASIC收入在絕對金額及佔總收入百分比方面的增長，反映了我們對AI ASIC定制服務的專注及投入。

我們的平台化模式

我們利用模塊化、智能化、自動化的IC技術平台，整合我們的設計能力與上下游資源，提供端到端的芯片定制服務。我們開發並授權專有高速接口IP，設計並定制採用先進工藝節點及2.5D/3D封裝的ASIC，並透過與第三方晶圓代工廠及OSAT夥伴合作交付芯片。在此模式下，我們主導從芯片架構設計、邏輯設計、可測性設計、物理設計到全生命週期管理的整個過程，並與晶圓製造、封裝測試領域的業務夥伴高效協同，確保覆蓋從4納米到28納米的工藝節點。

我們的平台化模式由以下核心特點定義。

- **IP複用與效率**：透過我們的模塊化IP庫和成熟的設計方法論，我們提供的芯片定制服務兼具設計效率、品質一致性與交付速度。
- **無縫的一站式服務**：從架構設計到芯片交付，我們最大限度減少多階段、多方協作帶來的負擔和潛在風險，確保項目進度。
- **快速跨領域擴展**：我們的平台化模式支持跨越多個領域（如AI和通信）的技術遷移，幫助客戶開拓新的應用場景。
- **基於經驗的專業知識積累**。儘管工藝節點持續迭代，我們的IC技術平台使我們能夠積累專業知識並豐富我們的設計工具鏈，從而增強我們識別及降低項目風險的能力，最終提高項目成功率。

業 務

我們的優勢

中國領先的國產一站式AI ASIC定制服務提供商，擁有先進的IC技術平台

我們自主研發了模塊化、智能化、自動化的先進IC技術平台。我們透過深度整合我們的專有IP、智能工具鏈和標準化流程，提供高效的一站式芯片定制服務。

我們戰略性地在三個領域開發專有IP：(i)高速數據接口、(ii)高速存儲接口及(iii)芯粒互聯接口。這些專有的高速接口IP使我們在AI開發領域佔據關鍵地位－隨著帶寬和算力需求的爆炸式增長，高帶寬、低延遲和低功耗的接口IP已成為不可或缺的需求。因此，我們的專有高速接口IP構成了AI ASIC定制服務的重要解決方案。

我們已自主研發兩個AI ASIC平台(包括一個雲端AI平台及一個邊緣AI平台)，以滿足多元化的客戶需求。此外，我們擁有內部工具鏈平台(包括一個前端設計工具平台及一個後端設計流程集成與交付平台)，以標準化研發及交付流程。這些平台共同支撐我們貫穿設計、驗證及交付全過程的一站式芯片定制服務。因此，該等平台顯著提高了設計效率，優化了成本結構，降低了芯片定制項目的失敗風險，並大幅縮短了客戶的上市時間，從而增強了客戶在市場中的競爭力，以及他們對我們的信任和忠誠度。

我們的IC技術平台將專有的IP(以及在必要時使用的第三方IP)進行模塊化，並將其嵌入至AI ASIC定制的全生命週期中。我們的平台化模式使我們能夠形成良性循環：專有IP提升了設計效率，而設計驗證又推動了專有IP的迭代升級。在ASIC定制過程中，來自實際應用的驗證數據持續推動著我們專有IP在不同工藝節點上的性能優化與可靠性提升，從而積累起一套涵蓋架構、驗證以及PPA優化的強大技術體系。這些經過規模化應用、持續迭代並經實際驗證的IP模塊，最終轉化為穩定的技術產出，構成了我們IC技術平台可複用的核心能力。這進一步推動了我們在芯片定制服務領域的持續進步。

以自主開發的專有高速接口IP為核心的IC技術平台

我們高度重視自主開發專有高速接口IP能力的戰略意義，將其視為我們IC技術平台的核心。我們的專有IP研發體系涵蓋了算法建模、模擬與數字電路設計、混合信號驗證、佈局實現以及後端整合。我們將先進工藝設計能力與芯粒架構迭代相結合，系統性地構建了一個覆蓋4納米至12納米先進工藝節點，適用於AI、高性能計算、網絡通信等高端應用的專有IP組合。

我們的專有高速接口IP能夠支持當前及下一代的高性能計算。

高速數據接口IP。它們基於32 Gbps至112 Gbps的SerDes技術，並支持PCIe Gen5及其他先進協議。它們是構建高性能服務器和高端網絡設備的基石，能夠處理海量數據吞吐量，並滿足雲計算和大型數據中心的嚴苛要求。

高速存儲接口IP。它們支持HBM3和LPDDR5x等先進標準，且我們已向市場推出基於4納米工藝節點的LPDDR5x PHY IP以供授權。作為當前AI芯片和高端GPU的核心內存解決方案，HBM3憑藉其高帶寬和能效，代表了目前存儲接口的高水平，服務於頂級AI和高性能計算市場。

業 務

LPDDR5x具備高帶寬、低功耗、高穩定性等優勢，能有效支持AI模型訓練與推理過程中海量數據的高速交互，提升系統計算效率與能效，在AI、邊緣計算及智能終端等領域發揮著不可替代的作用。

芯粒互聯接口IP。它們在芯粒架構上提供112 Gbps晶粒間高速超短距離互聯技術，並支持先進的2.5D/3D封裝。這些IP突破了單芯片的物理極限，能夠高效集成不同工藝節點和功能的芯粒，並在傳統芯片製造已接近物理極限時，為提升芯片性能開闢了一條關鍵路徑。

目前，我們正基於國內可獲得的最先進工藝節點，推進112 Gbps長距離SerDes的研發。該IP是實現AI芯片互聯、讓成千上萬張計算卡高效協同工作的關鍵技術。它是我們芯片定制服務最重要的基石之一。

我們深度參與了芯粒互聯接口規範系列標準的制定，其中包括中國的五項推薦性國家標準，該系列標準已於2026年3月1日正式實施。作為芯粒領域的首批國家標準，它們標誌著中國在芯粒標準化方面取得了里程碑式的突破。我們參與這些國家標準的制定，凸顯了我們在芯粒互聯領域定義行業規範的技術實力和權威性，鞏固了我們在國內高端IP領域的領導地位。

透過持續加強專有IP的廣度、深度以及工藝適配的靈活性，我們不僅有效降低了外部技術依賴的風險，更構建了一個涵蓋設計方法論、工藝協同優化、量產驗證的多維度芯片定制體系。

領先的複雜芯片設計與先進物理實現技術能力，精準匹配高端市場需求

我們的芯片定制能力涵蓋從芯片系統架構定義到納米級物理實現的全過程，成功克服了超大規模集成設計的複雜性挑戰和單芯片物理尺寸的限制。我們定制的高端芯片覆蓋了AI訓練與推理、高速存儲、網絡通信等核心領域。

我們具備複雜的芯片設計能力。我們不僅掌握了基於4納米或5納米等先進工藝節點的超大規模系統級芯片集成技術，還專注於芯粒異構集成架構。依託專有的112 Gbps晶粒間互聯技術，我們將受光罩尺寸限制的單片大型芯片拆解為由多個芯粒協同工作的高性能異構集成系統。該架構有效解決了AI訓練芯片對算力無限擴展的迫切需求。例如，我們的4納米AI服務器芯片成功突破了傳統單芯片在物理尺寸和性能上的限制。通過專有的112 Gbps超高速互聯技術和2.5D先進封裝設計，我們創新構建了高帶寬異構集成系統，實現了高達224 GB/s的芯片間連接速度和超過160 TOPS的算力。同時，該芯片採用RISC-V CPU作為管理核心以優化功耗，支持HBM3.0高帶寬內存及16個高速接口，內存訪問帶寬達819.2 GB/s，突破了制約AI性能的內存牆瓶頸。在確保信號傳輸性能遠超行業標準的同時，該芯片在萬卡級集群規模下實現了高能效與零抖動穩定運行，充分展現了我們在先進工藝技術下交付世界級複雜大芯片的卓越能力。

業 務

我們還具備先進的物理實現能力。作為率先實踐系統技術協同優化(STCO)理念的先行者之一，我們打破了設計、工藝和封裝之間的傳統壁壘。我們的重點不僅限於芯片定制週期各個階段的性能優化，而是通過早在架構定義階段即將系統級需求、工藝生產能力及封裝物理極限引入協同迭代，實現整體系統優化。這有助於我們實現IP及芯片設計的最佳性能，使我們能夠精確滿足高端市場對高帶寬、低功耗、快速上市時間及自主性的嚴苛要求。這可最終使我們成為少數有能力交付複雜大型芯片，並助力客戶在算力競爭中脫穎而出的關鍵戰略合作夥伴之一。

與全球及國內產業鏈建立強大的業務協作，構建穩定交付體系

在半導體行業供應鏈波動加劇和複雜的地緣政治環境下，我們始終維護一個既整合世界級資源，又兼顧國內自主可控的供應鏈生態系統。透過與全球巨頭及國內領先企業的合作，我們正在建立業界領先的穩定交付體系，這不僅確保了營運的連續性，也為客戶提供了從設計到交付的全週期安全保障。

我們與全球半導體領導者建立了值得信賴的合作關係。我們在先進工藝節點上，對我們的關鍵IP進行開發與工藝適配驗證，實現了我們IP性能與全球巨頭工藝參數的精準耦合。因此，我們獲得全球巨頭最先進工藝節點支持的優先權並與其建立穩固的業務關係。在先進工藝產能全球短缺之際，我們的優先權代表了業界對我們技術實力和商業信譽的高度認可，使我們能為客戶穩定供應具有全球競爭力的尖端產品。

在國內供應鏈方面，我們積極參與主流國內晶圓代工廠先進工藝節點的基礎IP開發。憑藉對先進工藝的深刻理解、架構設計能力以及為國內主流晶圓代工廠開發基礎IP的經驗，我們成為國內首批掌握先進工藝節點設計規範與特性的企業之一，與領先的晶圓代工廠構建了專屬的合作壁壘，形成了穩定且可持續的技術合作生態系統，並為下游客戶提供高適配性、高可靠性的芯片設計支持。因此，我們在國內先進工藝生態系統中佔據有利位置，助力客戶產品在國產生產線上實現最佳的PPA，打破高端芯片對海外供應鏈的依賴。

針對芯粒和高性能計算對先進封裝的嚴苛要求，我們已與國內領先的封裝測試公司簽訂長期戰略合作協議。透過鎖定其專用先進封裝生產線的產能，我們正在突破行業的產能瓶頸，助力高密度互聯場景下複雜大芯片的良率提升和快速量產。這使我們在封裝設計上建立了深度協作機制和優先產能保障通道，顯著提升了複雜大芯片的交付確定性。

依託全球與本土並重的佈局，我們已助力客戶構建了具有韌性的供應鏈。我們能夠靈活調配國際與國內的高質量資源，在具備先進工藝節點、核心IP及高端產能保障的地區，為客戶提供穩定的交付服務。這使我們成為那些希望在不確定的環境中實現穩定發展的高端客戶的首選戰略合作夥伴。

業 務

經驗豐富、擁有深厚行業背景並具備國際視野的團隊

我們的核心團隊由半導體行業資深專家領導，平均從業經驗約20年。他們曾深度參與多款國際高端芯片從架構定義、先進工藝到封裝設計及芯片交付的全過程。該團隊結合了全球技術視野與本土行業經驗，在AI ASIC、芯粒異構整合、高速接口IP等關鍵領域擁有紮實的工程實現能力。他們能夠準確評估技術趨勢，高效制定研發路徑，為我們的戰略方向 and 技術路線圖提供有力指導。

在核心團隊的帶領下，我們建立了結構完善的研究及技術團隊。截至2025年12月31日，我們擁有317名研究及技術員工，佔員工總數的81.7%。我們的研究與技術人員涵蓋芯片架構、IP開發、物理實現、封裝協調、量產驗證等領域，形成了持續迭代的技術儲備和創新能力。他們分佈於北京、上海、南京、蘇州、無錫、成都等中國國內核心的半導體產業區域，為我們的可持續發展提供長期支持。

我們的戰略

持續擴大專有高速接口IP組合，鞏固IC技術平台的根基

鑒於全球算力競爭和國內自主可控的需求，我們將持續投入並研發自主可控的專有高速接口IP，保持技術的先進性，並鞏固我們IC技術平台的根基。我們將繼續專注於三個關鍵領域：(i)高速數據接口（如112 Gbps長距離SerDes和224 Gbps長距離SerDes），(ii)高速存儲接口（如HBM3e、LPDDR5x和LPDDR6），及(iii)芯粒互聯接口。我們的目標是建立一個更全面的企業級IP庫，覆蓋數據傳輸、數據存儲和芯粒互聯的全鏈條，為AI ASIC定制服務提供核心支持。

憑藉我們的112 Gbps晶粒間互聯技術以及在國家芯粒標準化中的領導角色，我們正將戰略重點轉向芯粒異構整合平台，將經過硅驗證的高速接口IP模塊轉化為標準化、可複用的芯粒產品，並增強與UCIe等其他互聯標準的兼容性。

我們將進一步加強並迭代我們的雲端及邊緣AI ASIC平台，以提升芯片定制能力，持續滿足客戶的嚴格需求。此外，我們將豐富內部工具鏈平台（包括前端設計工具平台及後端設計流程集成與交付平台），以強化標準化研發及交付流程。

構建開放協作的AI硬件生態系統，打造國產AI ASIC新標桿

我們計劃構建一個開放協作的AI硬件生態系統，旨在成為中國國內AI ASIC領域的標桿企業。為因應雲端、邊緣、終端對AI大模型訓練和推理的多樣化算力需求，我們將不僅限於提供技術服務，更致力於連接算法供應商、系統整合商、晶圓代工廠與測試廠商、各垂直領域的終端用戶等產業鏈核心參與者。一方面，我們將利用我們在專有高速接口IP、先進工藝ASIC定制以及

業 務

2.5D/3D封裝設計方面的一站式優勢，降低高性能AI ASIC的開發門檻和迭代週期，使客戶能夠快速實現算力部署。另一方面，我們將與上下游合作夥伴共同努力，推動形成AI硬件系統（包括邊緣AI服務器）、互連芯粒及內存組件的完整本土化供應鏈。

加強與晶圓代工生態系統的合作，構建雙軌工藝協同體系

我們將繼續堅持輕資產策略，並與全球領先的晶圓代工廠及國內主流工藝平台建立合作關係，重點聚焦於開發基礎IP與工藝協同優化，將技術能力與生產資源整合，為客戶提供涵蓋先進到成熟工藝節點的全譜系產能保障，顯著提升項目交付的確定性和供應鏈韌性。

在國際方面，我們將鞏固與全球領先晶圓代工廠的現有業務關係。透過參與3納米或2納米等先進工藝節點的早期設計技術協同優化，我們優先獲得最新工藝節點的設計規則、模型庫和產能支持，確保我們的專有IP和ASIC定制服務符合最高國際性能標準，滿足高端客戶對最佳PPA的追求。在國內方面，我們將參與國內先進工藝產線的生態共建，開展基礎IP驗證、工藝特性模型化以及良率提升項目，推動國內工藝節點在高端芯片領域的影響力與應用。

實施全球化戰略佈局，構建開放包容的IC生態系統

我們將實施全球發展戰略，旨在成為有國際影響力的IC技術平台。

我們將積極拓展全球營銷和服務網絡，融入國內及全球主流半導體供應鏈，將我們的一站式服務推廣給具有全球影響力的雲服務供應商、系統製造商和AI企業，實現市場版圖的多樣化擴張。此外，我們將借助全球視野，在世界各地的半導體創新中心設立研發中心或聯絡處，廣泛吸引擁有前沿經驗的系統架構師和工程專家，組建多元化、互補的頂尖人才團隊，確保技術的持續領先。

我們將審慎地把握戰略併購機會，以優化資源配置。儘管我們主要通過內生增長實現發展，但我們將靈活評估並有選擇地收購與我們業務互補的高質量目標，例如具備互補性IP技術、特定領域設計能力或關鍵客戶渠道的目標，以快速完善技術佈局或加速區域市場滲透。具體而言，我們可能基於以下一般遴選標準考慮專門從事IC行業IP研發的潛在目標：(i)目標的業務應與我們的業務產生協同效應或形成互補；(ii)目標的管理團隊或研發團隊應具備相關行業知識、豐富經驗及強大的行業創新實力；(iii)目標不得捲入重大法律糾紛或合規問題；及(iv)目標應具備明確的知識產權以避免潛在專利糾紛。根據灼識諮詢的資料，截至2025年12月31日，市場有超過50個潛在目標符合我們的遴選標準。截至最後實際可行日期，我們尚未識別任何確切的收購目標且尚未與任何確切的收購目標進行磋商。

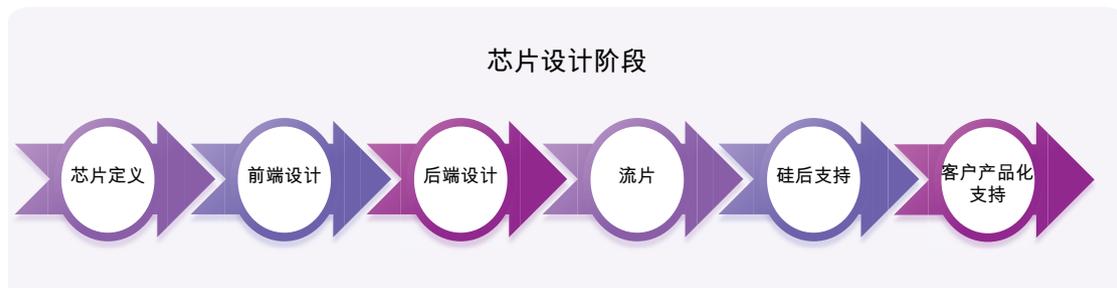
我們的芯片定制服務

芯片設計

芯片設計涵蓋芯片定義、前端設計、後端設計、流片、硅後支持及客戶產品化支持。

業 務

下圖載列芯片設計的關鍵階段。



- **芯片定義。**我們與客戶合作對芯片要求、規格及架構進行定義，並提供IP選擇和集成解決方案為後續設計奠定基礎。
- **前端設計。**我們將定義的架構轉化為寄存器傳輸級別代碼（RTL代碼），進行設計驗證，並開發原型和固件，以驗證芯片設計的正確性和可行性。
- **後端設計。**我們通過綜合、物理實現和封裝設計，將經過驗證的RTL代碼及可測性結構設計轉化為物理布局，保證了可製造性。我們的物理實現工作流程包括規劃、時鐘樹綜合、布線、時序簽核和功效分析。
- **流片。**我們將GDSII文件交付給晶圓代工廠進行芯片流片，晶圓代工廠據此生產用於晶圓製造的光掩模。在生產之前，我們進行流片工程作業審查（即逐層驗證光掩模的正確性），以驗證製造和設計的合規性。
- **硅後支持。**我們持續推動良率提升，優化測試程序，並在整個製造生命週期中實施嚴格的質量控制。
- **客戶產品化支持。**我們與客戶合作，進行系統性測試、應用調試和合規性測試。

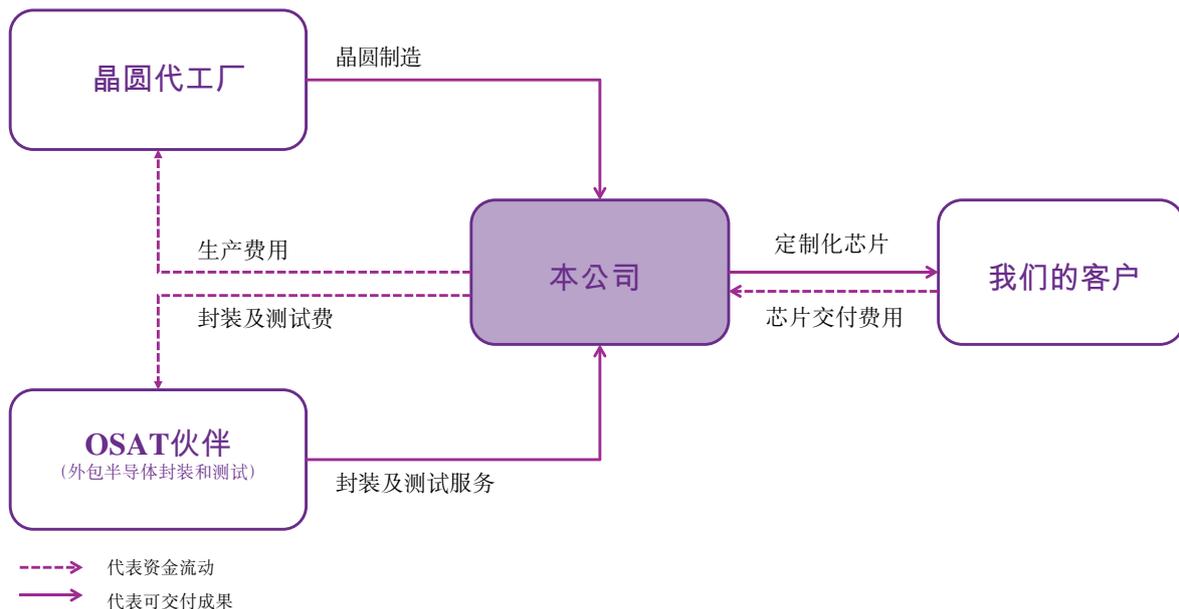
芯片交付

為更好地服務客戶，降低客戶開發成本並提高效率，我們亦根據客戶需求提供端到端芯片交付。我們的芯片交付流程包括以下關鍵階段：

- **晶圓級硅片驗證。**我們執行全面的硅片驗證，包括硅片的性能與可靠性測試。
- **先進封裝與測試。**我們提供先進的封裝解決方案，這些解決方案涵蓋了多種技術，包括倒裝芯片、系統級封裝、多芯片模塊以及2.5D/3D封裝等。我們還進行成品測試，確保出貨前封裝芯片的質量、性能與可靠性。
- **供應鏈協同。**我們與第三方晶圓代工廠及外包半導體封裝和測試合作夥伴（我們稱為OSAT夥伴）緊密協作，確保芯片的穩定量產。通過整合管理整個供應鏈，我們將合格的芯片產品交付給客戶。這涉及建立協同合作機制、進行生產規劃與預測、訂單處理、庫存管理，以及專業的物流安排，包括運輸、清關和標籤設計。

業 務

下圖說明我們的芯片交付模式及與主要利益相關者之間的關係。



在第三方晶圓代工廠生產執行過程中，我們與相關服務供應商就技術規格、生產進度和質量要求進行協調，並參與質量控制及良率提升等關鍵階段。設計中體現的某些專有IP的所有權仍歸我們所有。我們向晶圓代工廠及OSAT夥伴的付款通常乃按晶圓及產量定價基礎作出，結算條款通常遵循協議中規定的里程碑、交付及約定信用條款。除商業必要情形外，我們一般不會為確保產能而支付預付款項。

我們與客戶在產品開發和商業化全過程中保持緊密協作。根據具體合作需求，我們的交付成果通常包括附帶技術文檔的定制化AI ASIC。我們參與客戶從產品定義、規格協調到設計支持及性能优化的多階段協作，確保設計方案高效融入終端產品。通過這種協作模式，我們致力於為客戶提供高性能、低功耗且成本优化的芯片，從而縮短客戶開發周期、提升產品競爭力並增強整體系統性能。

IP授權

我們的芯片定制服務主要由內部自主研發的專有IP，並輔以精選的第三方IP組合共同推動。我們當前的專有IP聚焦於芯片接口，以全系列AI芯片接口為特點，構成了進一步推動AI發展的基石。完成研發、驗證及生產驗證後，我們將專有IP授權給客戶，用於其自身的芯片開發項目。部分IP也會用於我們自己的芯片定制服務中。交付成果通常包含授權IP、相關技術文檔、集成和實施指南及持續技術支持。

此外，我們還參與了國內先進工藝節點晶圓代工廠基礎IP的開發工作，形成推動本土工藝技術成熟的強大生態系統。

業 務

定價

芯片設計

芯片設計通過與客戶公平協商按項目定價，綜合考量技術規格、定制需求、項目周期及項目非經常性工程等因素，並通過工作說明書及合約與客戶確認。支付條款通常按里程碑基礎制定，款項與訂單或協議約定開發階段的達成情況掛鉤。

芯片交付

芯片交付的定價考量因素包括工藝節點、晶圓成本、封裝非經常性工程和成本、支持性非經常性工程及產量。測試夾具成本 — 包括探針卡、負載板以及測試座等項目的費用 — 以及相關的測試成本，同樣被納入我們的定價考量。我們收取的總費用將基於每片芯片階梯價格和交付量。在商業上合適的情況下，我們也可能向特定客戶提供批量折扣或長期供應安排。

IP授權

IP授權按(i)IP授權費或(ii)採用我們的IP生產的芯片的芯片交付特許使用權費收取。IP授權費通過與客戶公平協商按項目定價，考量因素包括IP的技術規格與性能要求、定制化程度、預期交付量、現行市場費率、競爭格局及客戶關係的長期潛力。我們的特許使用權費通常採用基於使用量的收益分成模式，按採用我們的IP生產的芯片的平均售價百分比或固定單價計費，並於客戶商業化生產銷售後支付。因此，我們的特許使用權費與客戶出貨量緊密掛鉤，實現了持續且可擴展的收入。IP授權費的付款一般由全額預付款項，亦可能包括預付款項及隨後的里程碑基準付款組成。特許權使用費的付款按協議規定定期收取。

項目儲備及執行表現

下表載列於往績記錄期間我們按合約價值計算的項目儲備變動。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
		(人民幣千元)	
於年初的合約價值(不含增值稅)期初結餘..	130,909	454,344	486,827
加：年內獲得的合約價值(不含增值稅)....	398,237	380,039	492,886
減：年內確認的收入.....	74,802	347,556	484,196
於年末的合約價值(不含增值稅)期末結餘..	454,344	486,827	495,517

業 務

下表載列於往績記錄期間我們按合約數目計算的項目儲備變動。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
由往年結轉的項目	22	26	18
加：年內獲得的新項目數目	45	31	64
減：年內完成的項目數目	41	39	55
結轉至下年度的項目	26	18	27

於2023年至2025年，年末合約價值的年末餘額同比增加，主要是由於業務持續增長帶動簽署合約量增加。

於往績記錄期間，於2023年、2024年及2025年分別有零個、2個及8個虧損項目。我們錄得該等項目虧損乃主要由於我們爭取戰略客戶及培養長期合作的策略所致。往績記錄期間虧損項目的大多數客戶後續與我們訂立新合約。於2023年、2024年及2025年，該等項目產生的虧損總額分別為零、人民幣0.1百萬元及人民幣6.6百萬元。於往績記錄期間，虧損項目應佔的收入及毛損相對於我們的總收入及毛利而言通常微不足道。因此，存在該等虧損項目並未對我們的整體業務營運造成重大不利影響。

應用類型

AI ASIC

我們戰略性地專注於端到端定制化AI ASIC設計。為主要從事數據中心、邊緣計算服務器、汽車、移動設備及其他相關行業的客戶提供先進AI ASIC定制服務。

下表載列我們芯片定制服務覆蓋的主要AI ASIC類別。

類別	主要特點	主要應用場景
雲端AI ASIC	<ul style="list-style-type: none"> • 超高計算密度 • 海量帶寬 • 低延遲互連 	<ul style="list-style-type: none"> • 數據中心 • 大規模AI模型訓練及推理 • 高性能計算集群
邊緣AI ASIC	<ul style="list-style-type: none"> • 兼顧高性能與適度功耗 • 實時處理 • 支持5G基礎設施及工業AI工作負載 	<ul style="list-style-type: none"> • 工業AI系統 • 邊緣計算網關與服務器
終端AI ASIC	<ul style="list-style-type: none"> • 超低功耗 • 高集成度 • 緊湊外型 • 專為移動或嵌入式設備及設備端AI推理優化 	<ul style="list-style-type: none"> • 汽車 • 移動或嵌入式設備 • 智能終端 • 消費級及物聯網產品的設備端AI推理

通信ASIC及其他

我們亦提供通信ASIC及其他應用的芯片定制服務，包括通信與無線ASIC、數據中心網絡與互聯ASIC。

業 務

下表載列我們芯片定制服務覆蓋的通信ASIC及其他芯片類型。

類型	主要特點	主要應用場景
通信與無線ASIC	<ul style="list-style-type: none">• 高速數據傳輸與信號處理• 無線連接應用處理• 支持5G及下一代無線通信標準• 集成多種通信協議與接口IP• 優化低延遲、能效及信號完整性	<ul style="list-style-type: none">• 5G基礎設施與無線通信系統• 網絡與電信設備• 無線模塊與連接系統
數據中心網絡與互聯ASIC	<ul style="list-style-type: none">• 實現高速數據傳輸• 高帶寬、低延遲數據交換與互聯能力• 支持高速接口標準與芯片間互聯• 適用於數據中心及雲基礎設施的可擴展架構• 優化可靠性與能效	<ul style="list-style-type: none">• 數據中心與雲計算基礎設施• 高速網絡與交換系統• 高性能互聯結構

我們的專有IP組合

我們在高速數據傳輸和存儲接口技術領域建立了強大的能力，這些技術對AI和高性能計算芯片至關重要。我們的技術使芯片能夠在芯片之間以及處理器與內存之間快速可靠地傳輸海量數據，從而有效解決AI系統中最大的性能瓶頸之一——數據帶寬和延遲問題。

我們的專有IP組合包括高速數據接口IP、高速存儲接口IP及芯粒互聯接口IP，主要服務AI相關應用不斷增長的性能需求。

- **高速數據接口IP**。我們的高速數據接口IP可在芯片與外部系統間實現快速可靠的數據傳輸。這些解決方案通過在複雜硬件環境中提供穩定的高帶寬連接，支持先進計算和AI應用。
- **高速存儲接口IP**。我們的高速存儲接口IP使處理器和計算芯片能高效地與存儲模塊通信。這些解決方案支持高數據吞吐量和低延遲，這對AI和高性能計算工作負載至關重要。
- **芯粒互聯接口IP**。我們還開發用於先進封裝和芯粒架構的芯粒互聯IP。這些解決方案可在保持強勁能效和可靠性的同時，實現AI加速器和高性能計算系統內部的高效數據交換。

業 務

下表載列我們的核心專有IP組合。

類型	主要優勢	特點	主要應用場景
<p>高速數據接口IP：</p> <p>32G MP SerDes及PCIe Gen5.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> 支持1至32 Gbps數據速率的多協議，集成協議子系統及突發模式時鐘與數據恢復功能，適用於無源光網絡應用 完全自主IP設計，具備專有集成與定制能力 採用先進鎖相環與高性能接收架構，實現低功耗、小面積與高性能 全面支持芯片級與系統級集成、封裝、電源及信號完整性，並提供熱協同設計 	<ul style="list-style-type: none"> 模塊化架構包含多數據通道、通用通道及合成通道 先進架構兼具低功耗、緊湊面積與高性能，支持多種協議標準 靈活時鐘方案，多級鎖相環支持可配置數據速率及多通道聚合及分流 適用於跨互聯網連接、存儲和通信標準的應用的高協議靈活性 	<ul style="list-style-type: none"> PCIe 5.0應用，包括AI服務器、網絡、交換機、重定時器、無源光網絡及現場可編程門陣列等
<p>高速數據接口IP：</p> <p>112G LR SerDes及PCIe Gen6.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> 支持1至112 Gbps數據速率的多協議，涵蓋以太網和PCI Express，內置協議子系統實現快速片上系統集成 完全自主IP設計，具備專有集成與定制能力 採用先進數字信號處理架構，通過自適應算法實現低功耗、緊湊面積與高性能 全面支持芯片級與系統級集成、封裝、電源及信號完整性，並實現熱協同設計 	<ul style="list-style-type: none"> 模塊化架構包含八條數據通道、一條通用通道及一條合成通道 高性能數字信號處理架構，可在複雜信道環境中實現強健信號恢復 符合最新行業標準，確保生態系統無縫兼容 	<ul style="list-style-type: none"> AI訓練與推理ASIC 高性能計算與數據中心基礎設施 網絡設備、智能網卡及加速卡 網絡交換機與路由器 台式機、工作站及服務器

業 務

類型	主要優勢	特點	主要應用場景
高速存儲接口IP：	<ul style="list-style-type: none"> 從電路到系統架構的全棧自主開發，實現深度節點級與應用級優化 卓越的信號完整性，採用低抖動時鐘架構，在工藝、電壓和溫度變化下仍能實現穩健的時序收斂 全面物理層功能，包括初始化、延遲校準、電壓溫度補償、阻抗校準、配置與狀態寄存器、內置自檢及內存控制器接口 支持符合JEDEC標準的高帶寬內存第3代及第3代擴展內存，數據速率高達9600兆比特／秒，兼容2.5D封裝 超高功耗、性能與面積優化 通過高密度模塊化架構與最小化時鐘樹佔用面積降低硅片面積 通過優化緩沖鏈與精簡時鐘路徑設計實現低延遲，滿足嚴苛的ONFI時序要求 	<ul style="list-style-type: none"> 模塊化和高度適應性：按需組裝，支持多樣化的輸入或輸出切片 定制化模擬時鐘樹設計，具備低偏移與強抗噪特性 優化實現高性能、低延遲、小面積、低功耗及易集成特性，以硬宏形式交付並支持靈活控制配置 集成輸入輸出模塊與鎖相環模塊，支持靈活配置並兼容各類內存設備 採用解耦設計實現靈活可擴展的模塊化複用架構 全面支持保留模式與睡眠模式的ONFI電源管理 精細化時鐘門控技術，實現性能與功耗的最優平衡 	<ul style="list-style-type: none"> AI訓練與推理ASIC 高端智能手機 高級駕駛輔助系統 高性能AI訓練與推理ASIC 圖形處理 網絡設備 企業級固態硬盤 AI固態硬盤 移動和汽車應用
LPDDR5x.....			
高速存儲接口IP：			
HBM3/3E.....			
高速存儲接口IP：			
ONFI 5.1.....			

業 務

類型	主要優勢	特點	主要應用場景
芯粒互聯接口IP： 112G XSR/XSR+ D2D/C2C.....	<ul style="list-style-type: none"> • 短距離晶粒間與芯片間互連，1至112千兆比特每秒傳輸速率，控制器與物理層子系統 • 全自主設計，核心集成完全自主，支持定制化調優及針對2.5D/3D封裝的分析 • 全模擬架構，低功耗，小硅片面積，高性能 • 全面支持集成、封裝、電源完整性與信號完整性、熱協同設計及技術服務 	<ul style="list-style-type: none"> • 靈活布局，獨立收發硬核宏，各含八條數據通道、一條公共通道及一條合成通道 • 超低功耗，高數據速率下高性能模擬設計 	<ul style="list-style-type: none"> • 高性能計算與AI ASIC • 工作站與服務器ASIC • 晶粒間與芯片間互連

業 務

我們的技術

可複用AI ASIC設計與工程能力

我們建立了全面且可複用的AI ASIC設計與工程能力，以支持高效、高質量、快速地開發定制化AI ASIC。

為滿足客戶的多樣化需求，我們研發了兩大核心專有AI ASIC平台：邊緣AI ASIC平台和雲端AI ASIC平台。我們的專有AI ASIC平台採用高度模塊化架構，構建了覆蓋核心算力、子系統集成到系統級組裝的全棧能力，為高效的ASIC開發和快速交付奠定了堅實基礎。

在整個設計與驗證流程中，我們注重開發內部自動化工具和流程，以提高效率、質量、一致性和成本效益，同時縮短開發周期。這些工具包括用於自動化設計的SoC工具包、內存子系統生成工具、自動化設計流程管理工具，以及智能驗證工具。

借助專有的定制化設計流程集成與交付平台，我們建立了覆蓋芯片全生命周期的標準化研發與交付體系。該平台能夠實現從綜合、DFT、物理實現到簽核的端到端自動化管理。

先進2.5D/3D與異構集成技術

我們正構建先進的2.5D/3D及異構集成技術，以支持新一代芯片架構。

我們的2.5D/3D設計方法以跨領域協同為特徵，這要求具備橫跨芯片設計與封裝設計的全面能力。與傳統將芯片設計與封裝環節分離的做法不同，我們的方法將芯片架構與封裝方案的協同優化邏輯前置到芯片定義初期。該方法根植於我們的技術平台，該平台通過眾多高端芯片項目沉澱了標準化、可擴展的設計方法。這種平台集成式的方法論能夠統籌考慮芯片功能需求、性能指標、封裝形式，支持為不同場景制定最優的2.5D/3D集成解決方案。借助這種跨領域協同設計方法，能夠有效提升芯片集成密度，降低信號延遲與功耗，充分滿足AI、高性能計算等前沿領域對高性能和高可靠性的需求。

為了進一步提升我們2.5D/3D及異構集成技術的競爭力，我們自主研發了3D DRAM控制器IP。作為連接邏輯芯片與3D DRAM內存的核心橋樑，我們專有的3D DRAM控制器IP專門針對2.5D/3D堆疊場景進行了優化，能夠在邏輯單元與3D DRAM內存之間實現高效的數據傳輸與管理。通過提升3D-DRAM帶寬利用效率，該控制器提供高效的數據供給，支持萬億參數級AI模型的高效訓練與推理。

研發

我們對創新的深厚熱忱，加上強大的研發能力，使我們擁有顯著的技術優勢。我們堅信研發投入是增長戰略的基石，更是競爭優勢的核心驅動力。我們的技術始終站在創新前沿，專注於尖端技術的研發。截至2025年12月31日，我們在中國主要城市設有7個研發中心。

業 務

我們的能力

自創立以來，我們對研發的大量投入推動了公司快速發展，使我們能夠持續優化解決方案組合並提升技術能力，包括招募、培訓和留住經驗豐富的頂尖技術人才。

截至2025年12月31日，我們有317名研究與技術員工，佔員工總數的81.7%。研究與技術團隊支持我們的研發舉措並在需要時承擔設計項目的設計工作。核心開發人員在高性能芯片設計領域經驗豐富，助力我們持續提升現有產品性能、豐富產品組合，並強化我們在本行業的創新驅動競爭力。

我們持續投入研發人才與項目建設。於2023年、2024年及2025年研發開支分別為人民幣90.9百萬元、人民幣175.5百萬元及人民幣239.0百萬元。

我們的架構

我們建立了包括前端設計、後端設計及IP開發在內的三大核心研發部門。前端與後端設計部門主要負責研發我們專有的AI ASIC平台及設計方法，包括獨立研發內部設計與驗證工具、設計流程、內部工具及交付系統。IP開發部門專注於專有IP的閉環運營體系，貫穿研究、開發及商業化支持全過程。

我們通過具有競爭力的薪酬待遇及福利留住關鍵管理及技術人才，並投入培訓項目提升核心團隊能力。同時借助獵頭公司、校園招聘等渠道引進具備相關知識技能的候選人。

研發流程

我們依據發展戰略、行業趨勢及客戶需求篩選潛在研發項目。已建立全面流程，確保對研發活動實施嚴格管控。研發周期根據技術複雜度及客戶要求，通常在90天至540天之間浮動。

我們的研發流程被系統化地分為以下階段。

- **項目啟動及預研階段。**這一階段涉及可行性分析、執行計劃，以及設計或驗證方案的制定與評審，為規避風險、契合需求及確保投資效益奠定基礎。
- **設計開發階段。**我們的研究與技術團隊根據標準化流程及質量控制進行集成設計、開發、模擬及驗證，以減少缺陷、提高效率並促進技術複用。
- **驗證階段。**對於需要試產芯片流片的專有IP開發項目，GDS II文件會發送至代工廠，並在晶圓回片後進行硅驗證。對於其他項目，則對設計及模擬結果進行驗證。
- **項目結案階段。**在最終驗收後，項目隨之結案，並對成本、技術成果及主要經驗教訓進行總結，以促進經驗沉澱及研發流程優化。

業 務

知識產權

我們視商標、專利、域名、專有技術、商業秘密及類似知識產權為成功的關鍵要素。截至最後實際可行日期，我們擁有88項已獲授權的專利，均為中國境內的發明專利。截至最後實際可行日期，我們在中國擁有50項IC布圖設計登記、49項版權、9項註冊商標及1個域名。

我們通過自主研發獲取專利。截至最後實際可行日期，我們擁有全部專利及專利申請的所有權。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未遭遇任何可能對業務產生重大不利影響的知識產權侵權威脅或未決糾紛。

我們通過版權法、專利法、商標法、商業秘密保護、與員工簽訂的保密協議，以及與第三方供應商協議中的知識產權和保密條款，綜合保護知識產權。我們已建立一系列內部控制政策和措施，確保能夠保護自身知識產權，並在運營過程中避免侵犯、盜用或違反第三方有效可執行的知識產權。然而，我們無法保證在針對第三方的專利侵權訴訟中勝訴。請參閱「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－我們未必能在全球範圍內充分保護或執行我們的知識產權、專利權或商業秘密，且為此所作的努力可能成本高昂」。

有關我們重要知識產權的更多詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—B.有關我們業務的其他資料—2.重大知識產權」。

銷售及營銷

銷售團隊及戰略

我們的營銷部門負責提升品牌知名度，推廣新老產品，致力於擴大我們的知名度、影響力、覆蓋範圍及市場滲透率。截至2025年12月31日，我們的銷售與營銷團隊包括24名成員。銷售團隊在中國各地設有廣泛布局，並配備駐扎上海的專職項目實踐經理，負責監管各項目的全生命周期，提供專業化的端到端支持。

我們的銷售與營銷戰略旨在通過多維度銷售網絡、主動客戶互動及整合營銷舉措，強化品牌領導力、拓展市場覆蓋並深化客戶關係。

我們主要採用直銷模式。我們專注於與主要客戶建立長期合作關係，依托強大的客戶黏性與持續訂單保障。

營銷與品牌建設舉措

我們致力於將中茵微電子打造為創新與品質的代名詞。我們的營銷與品牌建設舉措包括：

- **優質交付與服務口碑。**我們專注於提供優質芯片設計與IP產品，並以強大的售後服務作為業務增長與客戶互動的核心。ASIC設計服務的售後服務通常涵蓋後問題調試、良率提升支持、測試程序優化及技術支持。IP授權業務的售後服務通常涵蓋技

業 務

術文檔、技術支持、集成及實施指引、培訓以及IP維護更新。我們的專業服務團隊確保全流程緊密協作與清晰溝通。這種可靠響應的承諾贏得了客戶深度信任，通過我們卓越的客戶留存率得以體現，並鞏固了我們作為值得信賴的合作夥伴的聲譽。

- **多渠道品牌傳播。**我們通過利用線上平台、行業領先媒體和參與行業活動的集成傳播方式提升品牌影響力，力求擴大我們的市場份額。
- **強化全球布局與市場認知。**未來我們將持續深化及提升於中國的市場地位，同時通過拓展銷售渠道、建立戰略夥伴關係、加強客戶互動及推進國際營銷，積極推進全球擴張，擴大國際業務版圖。這些舉措顯著提升了我們在全球IC設計市場的曝光率與品牌認知度。

業 務

我們的客戶

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括AI、通信及其他行業的芯片及系統供應商。於2023年、2024年及2025年，我們的五大客戶於各適用年度產生的收入分別佔我們總收入的74.4%、95.1%及78.3%，而我們的最大客戶於各適用年度產生的收入分別佔我們總收入的32.2%、81.5%及37.4%。

下表載列於往績記錄期間我們五大客戶的若干資料。

客戶	交易金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比 (%)	業務關係 開始年份	客戶背景	購買	信貸期	付款方式
截至2023年12月31日止年度							
客戶A.....	24,073	32.2	2022年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供高端通信芯片	芯片設計及芯片交付	預付款項或發票後30天	銀行電匯
客戶B.....	9,679	12.9	2022年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供邊緣AI芯片	芯片設計及IP授權	預付款項	銀行電匯
客戶C.....	8,333	11.1	2022年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供傳感器芯片	芯片設計及芯片交付	預付款項	銀行電匯
客戶D.....	7,641	10.2	2021年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供網絡安全芯片	芯片交付	發票後10至30天	銀行電匯
客戶E.....	5,979	8.0	2021年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供高性能計算芯片	芯片交付及IP授權	預付款項或發票後30天	銀行電匯
總計.....	55,705	74.4					

業 務

客戶	交易金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比 (%)	業務關係 開始年份	客戶背景	購買	信貸期	付款方式
截至2024年12月31日止年度							
客戶B	283,256	81.5	2022年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供邊緣AI芯片	芯片設計、芯片交付及IP授權	發票後30天	銀行電匯
客戶F	17,537	5.0	2022年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供CPU	芯片設計及芯片交付	發票後10天	銀行電匯
客戶G	13,351	3.8	2022年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供AI-DPU	芯片設計及芯片交付	預付款項	銀行電匯
客戶H	10,018	2.9	2024年	一家位於中國的公司，主要從事提供汽車電子，於香港聯交所上市	芯片交付	預付款項	銀行電匯
客戶I	6,689	1.9	2024年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供通信芯片	芯片設計	發票後30天	銀行電匯
總計	330,851	95.1					

業 務

客戶	交易金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比 (%)	業務關係 開始年份	客戶背景	購買	信貸期	付款方式
截至2025年12月31日止年度							
客戶B	181,240	37.4	2022年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供邊緣AI芯片	芯片設計、芯片交付及IP授權	發票後30天	銀行電匯
客戶H	114,807	23.7	2024年	一家位於中國的公司，主要從事提供汽車電子，於香港聯交所上市	芯片交付	預付款項	銀行電匯
客戶J	34,653	7.2	2024年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供服務器	IP授權	預付款項	銀行電匯
客戶K	25,915	5.4	2023年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供顯示芯片	芯片設計及IP授權	預付款項或發票後30天	銀行電匯
客戶L	22,381	4.6	2025年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供芯片解決方案	芯片設計	預付款項	銀行電匯
總計	378,996	78.3					

業 務

以下載列就我們的芯片設計與客戶訂立的合約的主要條款。

- **規格。** 協議明確規定具體設計服務、交付成果及項目時間表。
- **付款。** 客戶通常按里程碑基準付款。非經常性工程費用通常不可退還。若客戶取消項目，須承擔截至取消日產生的全部費用，包括第三方開支及內部人力成本。因客戶導致的項目延誤可能產生額外費用。
- **交付與驗收。** 技術交付需隨附驗收表提交。客戶通常有五個工作日進行審核簽字或提出異議。
- **知識產權。** 在規格輸入模式下，我們獨立開發的子系統歸我們所有，而集成ASIC設計歸客戶所有。在網表輸入模式下，設計方法論歸我們所有，客戶獲得該項目專屬使用權。
- **保證。** 我們保證服務不侵犯第三方IP。倘因我們的服務引發第三方索賠，在特定條件下我們將承擔相應損害賠償。
- **終止。** 協議可經雙方同意終止。

以下載列就我們的芯片交付與客戶訂立的合約的主要條款。

- **規格。** 協議明確規定我們的芯片交付與封裝及測試服務的具體範圍。
- **付款。** 向晶圓代工廠及封裝測試廠下單前，我們通常要求客戶支付全額預付款項。
- **客戶義務。** 客戶有義務根據合約條款完成付款，並提供估計量產規模。
- **交付。** 我們負責運輸安排並投保運輸險。貨物所有權及損失風險於客戶在指定交付地點簽收確認時轉移。
- **保密。** 我們須對客戶提供的技術資料嚴格保密，未經事先批准不得向第三方披露。
- **終止。** 協議可經雙方同意終止。

以下載列就我們的IP授權與客戶訂立的合約的主要條款。

- **付款。** 我們通常通過全額預付款項或預付款項及里程碑付款相結合的方式收取IP授權費。
- **規格。** 協議明確規定授權IP的範圍及將提供的相關技術服務內容。
- **限制。** 客戶僅可按合約協定範圍及方式使用我們的技術，不得超出許可範圍使用。
- **交付與驗收。** 我們按合約所載協定條件、時限及交付方式提供IP模塊。交付後通常給予客戶5天審查期，用於核查技術規格並確認驗收。

業 務

- **支持**。交付後我們通常提供12個月免費技術支持，期滿後按合約協定的費率收取年度服務費。
- **期限**。IP授權協議的有效期通常以採用許可IP的芯片生命周期為準。
- **知識產權**。我們保留技術中所有知識產權，客戶僅依據合約獲得有限使用權。
- **保密**。雙方同意未經事先書面同意，不得向任何第三方披露與合約或授權技術相關的保密信息。
- **終止**。IP授權協議可經雙方同意終止，或在另一方發生重大違約、破產或清算時終止。

於2023年、2024年及2025年，我們的五大客戶產生的收入分別佔我們總收入的74.4%、95.1%及78.3%。我們預期於可預見未來將繼續出現收入集中情況。

主要客戶收入貢獻集中主要是由於我們的業務模式性質所致，在此模式下，我們通常服務於數量相對有限的客戶，且每份合約價值重大，項目週期亦相對較長。

儘管我們來自於往績記錄期間各期間的五大客戶的收入較為集中，基於以下因素，董事認為，我們並無面臨任何重大的客戶依賴風險且我們的業務屬可持續：

- (i) 根據灼識諮詢的資料，客戶集中在來自AI相關應用的收入貢獻較高的芯片定制服務公司中屬常見，因為相關客戶群體相對集中且主要由數量有限的大型下游AI雲服務提供商組成；
- (ii) 除2023年的客戶A、2024年的客戶B以及2025年的客戶B及客戶H外，我們於往績記錄期間任何期間的五大客戶概無單獨貢獻我們同期總收入的15%以上。
- (iii) 自我們與有關客戶建立業務關係起，我們與往績記錄期間的所有五大客戶均維持穩定關係。若干關鍵客戶（例如客戶B）已於往績記錄期間與我們簽署經常性合約；
- (iv) 客戶B主要提供邊緣AI芯片。我們自2022年起與其開始業務關係並向其提供涵蓋IP授權、芯片設計及芯片交付的一站式服務。來自客戶B的收入佔我們2024年總收入的81.5%，因為我們完成與其簽訂的多份合約的芯片設計並於年內確認相應收入。然而，客戶B的收入貢獻後續降低至2025年的37.4%。因此，客戶B的收入集中於往績記錄期間有所降低；及
- (v) 我們一直積極擴大我們的客戶群體並於往績記錄期間成功獲得新的主要客戶（例如客戶H、客戶J及客戶L）。我們認為主要客戶與我們維持業務關係屬互惠互補。我們的專有高速接口IP、先進IC技術平台及技術、強大的執行能力以及經過驗證的客戶滿意度往績記錄增強了客戶對我們的信心及忠誠度，而我們於往績記錄期間不斷擴大的客戶群體證明了這一點。

業 務

於往績記錄期間各期間，我們的所有五大客戶均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，我們的董事、其緊密聯繫人或據董事所知於截至最後實際可行日期持有我們已發行股本5%以上的任何股東，均未於往績記錄期間各期間持有我們五大客戶的任何權益。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與客戶之間未發生任何重大爭議，亦未收到任何重大投訴。此外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無發生嚴重違反協議的情況。

我們的供應商

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括：(i)流片服務及晶圓供應商，(ii)第三方IP供應商，及(iii)半導體封裝材料供應商。

我們的採購團隊依據預期銷售額、生產周期及生產時間表制定採購方案。根據方案，我們向晶圓代工廠供應商下達採購訂單，由其根據我們的IC設計製造晶圓，並委託封裝測試合作夥伴完成芯片封裝與測試。

我們依據定價、產品質量、技術能力及交付表現等評估標準選擇供應商，並通過維護經批准供應商名錄確保標準統一與供應穩定。我們主要通過定期績效評估、質量檢驗及合約質量保障要求]管理供應商提供的產品與服務質量。

於2023年、2024年及2025年，我們的五大供應商於各適用年度的採購額分別佔我們總採購額的65.2%、85.7%及65.1%；最大供應商於各適用年度的採購額分別佔我們總採購額的28.1%、48.7%及22.9%。於往績記錄期間，我們的採購主要來自中國和韓國的供應商。

業 務

下表載列於往績記錄期間我們五大供應商的若干資料。

供應商	交易金額 (人民幣千元)	佔總採購額 百分比 (%)	業務關係 開始年份	供應商背景	採購的產品 或服務	信貸期	付款方式
截至2023年12月31日止年度							
供應商集團A	30,153	28.1	2021年	一家跨國集團，主要從事提供芯片解決方案，於納斯達克股票市場上市	原材料及IP	預付款項	銀行電匯
供應商集團B	23,450	21.8	2023年	一家跨國集團，主要從事提供EDA及IP，於納斯達克股票市場上市	IP	預付款項	銀行電匯
供應商C	6,368	5.9	2023年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供芯片設計服務	芯片設計服務	預付款項或發票後30天	銀行電匯
供應商D	5,555	5.2	2021年	一家位於中國的公司，作為半導體代工廠的代理商營運，於納斯達克股票市場上市	原材料	預付款項	銀行電匯
供應商E	4,490	4.2	2023年	一家位於中國的公司，主要從事芯片解決方案，於上海證券交易所上市	芯片設計服務	預付款項	銀行電匯
總計	70,016	65.2					

業 務

供應商	交易金額 (人民幣千元)	佔總採購額 百分比 (%)	業務關係 開始年份	供應背景	採購的產品 或服務	信貸期	付款方式
截至2024年12月31日止年度							
供應商F	107,672	48.7	2023年	一家跨國公司，主要從事半導體製造，於韓國交易所上市	原材料	預付款項或發票後 60天	銀行電匯
供應商G	50,924	23.0	2024年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供電子組件服務	原材料	預付款項	銀行電匯
供應商集團A	14,517	6.6	2021年	一家跨國集團，主要從事提供芯片解決方案，於納斯達克 股票市場上市	原材料	預付款項或發票後 30天	銀行電匯
供應商集團H	8,869	4.0	2024年	一家位於中國的集團，主要從事半導體製造，於上海證券 交易所上市	原材料	預付款項	銀行電匯
供應商I	7,499	3.4	2024年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供電子組件服務	原材料	預付款項	銀行電匯
總計	189,481	85.7					

業 務

供應商	交易金額 (人民幣千元)	佔總採購額 百分比 (%)	業務關係 開始年份	供應商背景	採購的產品 或服務	信貸期	付款方式
截至2025年12月31日止年度							
供應商G.....	47,399	22.9	2024年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供電子組件服務	原材料	預付款項	銀行電匯
供應商J.....	28,858	13.9	2024年	一家位於中國的非上市公司，作為半導體代工廠的代理商營運	原材料	預付款項或發票後 60天	銀行電匯
供應商K.....	23,000	11.1	2025年	一家位於日本的公司，主要從事提供電子組件服務，於東京證券交易所上市	原材料	預付款項	銀行電匯
供應商集團H.....	21,406	10.3	2024年	一家位於中國的集團，主要從事半導體製造，於上海證券交易所上市	原材料	預付款項	銀行電匯
供應商L.....	14,274	6.9	2024年	一家位於中國的非上市公司，主要從事提供半導體解決方案	原材料	預付款項	銀行電匯
總計	134,937	65.1					

業 務

以下載列我們與供應商訂立的購買協議的主要條款。

- **期限與終止**。我們與供應商的協議通常為期三年，經雙方協議後可予續期。如符合協議中規定的終止條件，我們有權通過書面通知立即終止協議。
- **價格**。對於我們已建立長期合作關係的若干供應商而言，框架協議未規定具體數量或價格。具體數量及價格詳情另行載於採購訂單。
- **主要義務**。供應商負責按時將貨物運抵我們的指定地點，承擔全部運費及保險費用，並確保符合質量標準。我們通常在收貨後七天內進行瑕疵檢驗。所有權及損失風險僅在簽署驗收單後轉移。
- **付款條款**。我們的供應商採用預付款項或後付費方式運營。對於後付訂單，我們通常於驗收並收到發票後30到60個工作日內結清相關金額。
- **保證**。我們通常規定自驗收之日起一年質保期。

於往績記錄期間各期間，我們的所有五大供應商均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，我們的董事、其緊密聯繫人或據董事所知於截至最後實際可行日期持有我們已發行股本5%以上的任何股東，均未於往績記錄期間各年度持有我們五大供應商的任何權益。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未因供應商質量問題或供應商違反協議而導致業務運營受到重大影響，亦未因供應短缺造成服務供應出現重大中斷。於往績記錄期間，原材料價格未出現重大波動。

客戶及主要供應商重疊

就我們所知，供應商C是我們2023年的五大供應商之一，亦為客戶E（我們2023年的五大客戶之一）的全資附屬公司。於2023年、2024年及2025年，我們產生自客戶E的收入分別為人民幣6.0百萬元、零及零，分別佔我們同期總收入的8.0%、零及零。於2023年、2024年及2025年，我們向供應商C的採購額分別為人民幣6.4百萬元、人民幣4.7百萬元及零，分別佔我們同期採購總額的5.9%、2.1%及零。我們於2023年向客戶E提供流片及IP授權服務。於2023年及2024年，由於人力限制，我們將專有IP的若干非核心研發工作流程外包予供應商C。根據灼識諮詢的資料，客戶及供應商重疊的情況在芯片定制行業中並非少見，因為根據行業的人力專業劃分及協作開發模式，半導體公司通常在價值鏈的不同環節中承擔著不同角色。我們向客戶E的銷售及向供應商C的採購乃單獨進行，並不互為條件。與客戶E及供應商C的交易乃於日常業務過程中根據正常商業條款按公平基準進行。

於往績記錄期間，供應商I是我們2024年的五大供應商之一，亦為我們2025年的客戶。於2023年、2024年及2025年，我們向供應商I的採購額分別為零、人民幣7.5百萬元及零，分別佔我們同期採購總額的零、3.4%及零。於2023年、2024年及2025年，我們產生自供應商I的收入分別為零、零及人民幣14.3百萬元，分別佔我們同期總收入的零、零及2.9%。於2024年，我們為項目

業 務

需要而向供應商I及其他供應商採購若干電子元件並建立額外存貨。於2025年，由於這些電子元件的存貨過多，我們應其要求向供應商I出售部分存貨。我們與供應商I的業務關係重疊在性質上屬一次性，而我們預計有關重疊將不會重複出現。

質量控制

服務質量及安全

我們已建立嚴謹且結構完善的質量管理體系，融合行業領先標準與最佳實踐，確保產品可靠性與客戶滿意度。我們的整體質量框架以ISO 9001質量管理體系為基礎，並在功能安全領域實施了道路車輛功能安全體系，獲得ISO 26262 ASIL-D認證。

從設計到生產，質量貫穿我們的整個服務生命週期。我們採用嚴格的驗證與確認流程，確保產品可靠性及符合行業標準，所有研發工作流與項目文檔均通過IT支持系統管理，保障一致性與可追溯性。通過全面的質量體系與工具培訓計劃及KPI驅動評估，我們積極提升質量意識。我們持續改進計劃鼓勵主動參與，對推動流程優化與創新的團隊予以獎勵。

此外，我們與客戶緊密協作，確保滿足其特定的產品開發、製造及運輸要求，同時通過全面的合約審查明確雙方預期。我們的客戶反饋機制使我們能夠及時解決問題並推動持續改進。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遭遇有關我們服務質量的任何重大糾紛。

信息安全及數據隱私

於業務運營過程中，我們主要收集及存儲與財務、運營、研發相關的內部數據，以及與商業夥伴的交易數據。除少量數據存儲於本地計算機或實體文件外，此類數據主要通過數字化IT系統進行管理。鑒於我們僅與企業開展交易，我們的業務通常不涉及收集或處理客戶個人信息。

我們所有的IT服務器均部署於自有數據中心，該中心設有訪問控制及自動化環境監測系統。系統訪問權限通過集中式IAM(身份與訪問管理)平台管控，該平台依據用戶角色實施身份驗證與授權管理，並接受內部審計審查。員工入職須簽署保密協議並接受數據保護規程培訓，離職時訪問權限將立即撤銷。文件管理方面，我們建立了保密文檔平台，將文件劃分為內部、機密、高度機密和絕密四個等級，並嚴格按保密級別限制訪問權限。

我們的運營環境與研發環境實現物理隔離。敏感數據及研發相關數據存儲於隔離環境中的專用物理存儲設備，並對數據訪問實施明確的訪問控制。敏感數據傳輸須按保密級別逐級經負責人審批，經批准後由IT部門通過相關系統執行傳輸操作，其他人員不得執行數據傳輸。

業 務

為強化數據安全防護措施，我們實施了涵蓋安全存儲協議及嚴密傳輸政策的綜合方案，確保敏感信息機密性與完整性。此外，我們建立了完善的信息備份管理體系，明確數據恢復的指導原則、詳細流程及機制。同時制定了信息安全管理方案，確立信息安全管理的總體方針與原則，並據此建立系列政策流程，包括（其中包括）系統運行管理政策、密碼管理政策、企業商業秘密保護政策、文件控制與保密管理流程。這些系統、政策和程序共同構築了堅實的框架，保障數據安全並維護我們嚴格的信息安全標準。

於往績記錄期間，我們未進行任何跨境數據傳輸。在業務運營過程中，我們可能根據適用法律及相關合約安排，在嚴格遵循「需要知悉」原則的前提下，與第三方共享自身業務相關數據。據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未因數據隱私和安全問題受到任何重大索賠、處罰或事件的影響，且董事認為我們已在所有重大方面遵守中國的數據隱私和保護法律法規。

僱員

截至2025年12月31日，我們有388名全職僱員。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的大部分僱員位於中國。

下表載列截至2025年12月31日按職能部門劃分的全職僱員明細。

職能	截至2025年12月31日	
	僱員人數	佔總僱員百分比
研究與技術.....	317	81.7%
管理及一般行政.....	47	12.1%
銷售及營銷.....	24	6.2%
總計	388	100.0%

我們堅信員工隊伍的實力與才華是我們業務成功的關鍵，因此持續致力於吸引、培養並留住符合業務需求的人才。我們始終致力於為員工提供全面的社會福利保障、豐富的職業發展機會以及多元化的工作環境。此外，我們承諾打造安全健康的工作場所，並通過嚴格的政策、完善的培訓體系及安全表彰制度予以保障。我們致力於員工的招聘、教育、發展與晉升，同時特別重視人才梯隊建設與凝聚力強的企業文化。我們已建立涵蓋專業能力、企業文化價值觀、職場道德、合規意識等主題的員工培訓發展體系。

我們根據多種因素招聘僱員，如IC設計行業經驗、教育背景及我們的崗位需求。我們主要通過社會招聘渠道吸納人才，輔以校園招聘構建均衡的人才儲備體系。

依據中國法律法規要求，我們參與由市級及省級政府組織的各類員工社會保障計劃，包括（其中包括）通過中國政府強制福利供款計劃實施的養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、

業 務

工傷保險及住房公積金計劃。根據中國法律規定，我們需不時為中國境內員工作出福利計劃供款，繳費比例按員工工資、獎金及特定津貼的特定百分比計算，最高不超過中國地方政府規定的限額。

我們致力於建立具有競爭力且公平的薪酬體系。為有效激勵員工，我們持續完善薪酬與激勵政策，定期開展績效評估並提供反饋。員工薪酬通常由基本工資、績效獎金及以股份為基礎的獎勵構成。

我們通常與高級管理層及核心僱員簽訂標準僱傭協議、保密協議及競業禁止協議。此類合約包含標準競業禁止條款，禁止員工在任職期間及離職後特定期限內直接或間接與我們競爭。我們與員工保持良好工作關係，迄今未發生重大勞資糾紛。

物業

截至最後實際可行日期，我們在中國境內不擁有任何土地使用權或物業。截至最後實際可行日期，我們主要通過在中國租賃的11處物業作辦公用途開展業務，總建築面積超過8,000平方米。

截至2025年12月31日，我們租賃物業的賬面值均未達到綜合總資產的15%或以上。根據上市規則第5章及《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第6(2)條，本文件獲豁免遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》第342(1)(b)條規定，無須將所有土地或樓宇權益納入估值報告，詳情載於《公司（清盤及雜項條文）條例》附表3第34(2)段。

租賃協議備案

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，儘管我們作出努力，我們仍未能完成用作辦公室的九項租賃物業的租賃登記，主要是由於業主尚未獲得所有權證書或個別業主不願配合辦理租賃登記備案。根據中國法律法規，我們可能需要向相關政府主管部門備案已執行的租賃。據我們的中國法律顧問所告知，未能為我們的租賃物業備案租賃協議不會影響這些租賃協議的有效性，但如果我們未能在規定時限內完成登記，主管房屋當局可能會命令我們在規定時限內備案租賃協議，並對每項未備案的租賃處以人民幣1,000元至人民幣10,000元不等的罰款。根據截至最後實際可行日期有效的協議，有關備案租賃協議的不合規情況的合計最高罰款將為人民幣90,000元。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們尚未接獲任何監管部門就該等未登記租賃產生的行政處罰或強制執行行動而發出的任何通知。倘我們被勒令作出有關付款，我們將在規定時限內及時作出。因此，董事認為該等未登記事項將不會對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。未來，我們擬於重續現有租約或訂立新租約時考慮出租人的業權及配合登記租賃協議的意願。

保險

我們認為我們的保險覆蓋範圍充分且符合所處行業的商業慣例。我們的僱員相關保險包括法定社會保險供款，涵蓋養老保險、生育保險、失業保險、工傷保險及醫療保險。此外，我們為全職僱員提供綜合性商業補充保險，涵蓋意外身故或傷殘、重大疾病及門診和住院醫療費用。我

業 務

們還將醫療保險覆蓋範圍延伸至僱員的合資格家屬。此外，我們持有涵蓋運輸過程中特定潛在風險與責任的第三方保險，如產品責任險。管理層將不時評估保險覆蓋的充分性，並視需要增購保險。

環境、社會及管治

我們認識到環境、社會及管治(ESG)因素是評估可持續發展和長期價值創造的關鍵。為加強管理能力，我們已制定《環境、社會及管治(ESG)管理辦法》，並建立了由董事會提供監督與決策，ESG工作小組負責管理與執行的ESG治理架構，以確保ESG實務的有效落實。

董事會作為ESG事宜的最高決策機構，負責審閱我們的ESG策略、目標、主要風險與機遇，評估年度計劃與績效，並在預算、政策及資源分配上提供支持。為執行董事會的決策，我們設立了ESG工作小組，負責日常ESG管理，包括推廣節能環保措施、管理ESG數據收集與報告，以及跨部門協調，將ESG要求融入日常運營。

環境保護

我們將環境保護視為可持續發展的基石，並嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》及其他適用的法律法規。由於我們的主要業務專注於芯片定制及相關技術服務，不涉及晶圓製造等能耗密集型工序，因此我們的營運不會產生重大的工業排放，包括廢水、廢氣或固體廢棄物。儘管如此，我們仍持續完善內部環境管理體系，重點關注辦公及研發場所的能源使用與辦公室廢棄物管理，以提高資源效率並減少日常運營對環境的影響。

資源管理

能源管理已被納入我們日常運營的重點關注領域。透過能源消耗監測、節能措施及提高員工意識，我們旨在提升能源效率。電力是我們最大的能源消耗來源。隨著業務增長，加強資源節約與利用效率，對於提升運營韌性與可持續性至關重要。因此，我們實施治理目標及節能減碳措施，以進一步優化能源使用。下表載列我們於往績記錄期間的用電量：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
能源消耗			
用電量(兆瓦時).....	458.9	910.0	1,365.9
能源消耗密度(兆瓦時/人民幣百萬元收益).....	6.1	2.6	2.8

為提高能源使用效率，我們根據業務特點制定了以下管理目標，並將每年追蹤進度：

- 預計到2030年，用電密度下降5.0%。

業 務

目前，我們主要採取以下措施來提高資源利用效率：

- 在非使用時間關閉辦公區域的空調及其他用電設備；
- 在非工作時間關閉照明及其他不必要的電子設備，並由行政人員定期巡查，以防止不必要的電力消耗。

排放物管理

無害廢棄物管理

我們的無害廢棄物主要來自日常辦公活動產生的紙張。於往績記錄期間，無害廢棄物總量隨業務擴張而增加，但排放密度有所下降。這主要是由於(i)採用了無紙化系統和數字協作平台，從源頭減少了紙張消耗；及(ii)改善了紙張分類和回收做法，提高了資源利用效率。下表載列我們於往績記錄期間的無害廢棄物排放量及排放密度：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
無害廢棄物總量 (噸)	0.3	0.5	0.7
無害廢棄物密度 (噸／人民幣百萬元收益)	0.004	0.002	0.001

應對氣候變化

識別及管理氣候相關風險

氣候變化對全球經濟和工業發展構成日益嚴峻的挑戰。我們積極響應中國的「碳達峰碳中和」戰略及全球氣候倡議，將低碳理念融入管理與運營。通過節能措施、綠色辦公實踐及供應鏈減碳行動，我們致力於提升氣候韌性與綠色競爭力。

我們已將氣候相關議題納入環境與風險管理框架。我們定期評估氣候變化對我們營運的潛在影響，並針對實體風險和轉型風險制定應對措施。已識別的風險、機遇、潛在影響及相應措施範例載列如下：

風險／機遇類型	描述	潛在影響	措施
實體風險			
極端天氣風險..	<ul style="list-style-type: none"> • 氣候變化引發的極端天氣事件，如強降雨、颱風、寒潮 	<ul style="list-style-type: none"> • 辦公及研發場所營運中斷 	<ul style="list-style-type: none"> • 加強辦公及研發場所的防災措施，完善應急預案與演練

業 務

轉型風險

- 技術風險.....
- 行業正向更低功耗、更高能效及採用綠色材料的方向發展
 - 技術路線落後可能導致競爭力下降
 - 投資關鍵技術以開發低功耗、高效率產品，並與上下游夥伴合作推動綠色供應鏈

- 政策風險.....
- 政策法規(包括對能源效率、碳排放及回收利用的要求)日益嚴格
 - 合規成本上升，披露要求和客戶要求提高
 - 監測監管法規和客戶要求，完善內部政策與合規培訓，建立標準化的數據與披露流程

機遇

- 市場拓展.....
- 在「碳达峰碳中和」目標驅動下，下游行業加快綠色轉型
 - 來自綠色供應鏈准入、ESG聲譽提升以吸引客戶與人才，以及政策支持與激勵的機遇
 - 通過加強碳數據管理、客戶溝通及ESG披露，把握相關機會

溫室氣體管理

根據適用的溫室氣體核算標準與指南，我們正逐步建立溫室氣體清單與管理框架，完善數據收集、計算、核查與記錄保存機制。我們的營運排放主要來自辦公及研發場所消耗的外購電力。在現有數據基礎和披露策略之上，我們正逐步擴大其他間接排放(包括商務旅行和員工通勤)的數據收集與披露。我們將持續監控氣候相關績效指標，並透過低碳實踐及探索綠色能源應用，進一步降低營運碳排放密度。下表載列我們於往績記錄期間的範圍2和範圍3溫室氣體排放量及排放密度：

溫室氣體排放	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
範圍2：直接溫室氣體排放(噸二氧化碳當量).....	321.2	637.0	956.1
溫室氣體排放密度(範圍2) (噸二氧化碳當量／人民幣百萬元收益).....	4.3	1.8	2.0
範圍3：間接溫室氣體排放(噸二氧化碳當量).....	78.5	136.2	103.8
溫室氣體排放密度(範圍3) (噸二氧化碳當量／人民幣百萬元收益).....	1.0	0.4	0.2

業 務

為減少溫室氣體排放，我們根據業務特點，並考慮業務規模變化、辦公及研發場所調整、員工結構演變及綠色電力使用情況，制定了以下管理目標，並將每年追蹤進度：

- 預計到2030年，溫室氣體排放密度下降5.0%。

目前，我們主要採取以下措施來降低排放密度：

- 將節能實踐融入日常運營，包括要求在不使用時關閉照明和空調系統，從而減少範圍2的溫室氣體排放；
- 利用數字協作平台和雲端會議系統，取代不必要的跨區域商務旅行，大幅減少來自交通運輸的範圍3排放；
- 推廣低碳通勤方式，鼓勵員工使用公共交通工具，從而減少日常通勤相關的碳足跡。

社會責任

僱傭及勞工準則

我們視僱員為關鍵資產，致力於提供公平、多元及安全的工作環境，並提供發展機會。我們持續完善人力資源管理體系，在招聘中遵循平等、多元化及不歧視的原則。所有員工均根據適用法律簽訂勞動合同，並享有商業保險、福利休假、福利積分及年度健康檢查等福利。我們已為辦公及研發場所建立安全與應急管理制度，並定期進行安全培訓與演練。此外，我們設有員工申訴與反饋渠道，並有嚴格的保密及公平處理程序，以保障員工權益。我們還提供涵蓋入職、專業發展及年度培訓的結構化培訓體系，包括公司政策與文化、專業技能、合規、信息安全及應急管理等內容。

知識產權管理

我們高度重視知識產權與商業秘密的保護，並嚴格遵守適用的法律法規，包括《中華人民共和國專利法》。我們已將知識產權保護納入公司治理與風險管理框架，並實施了《中茵微電子商業秘密管理制度》和《知識產權管理制度》等內部政策，以保護我們的研發成果與核心技術。通過涵蓋研發成果登記、專利申請、維權及商業秘密管理等程序，我們確保及時有效地保護技術創新。我們亦定期進行IP合規審查，並透過培訓加強員工意識，同時尊重他人的知識產權，保障我們技術資產的安全與獨立性。

客戶服務管理

我們高度重視與客戶建立長期合作夥伴關係，並持續改進我們的客戶服務與技術支持體系。我們定期與客戶進行技術交流，使我們的服務和技術路線圖與其產品規劃、升級需求及行業

業 務

趨勢保持一致，以滿足不斷變化的要求。通過結構化的研發流程和嚴格的項目管理，我們提高了服務效率與質量管理。我們還建立了技術支持與客戶反饋機制，以便及時處理技術和質量問題，提升客戶滿意度。展望未來，我們將持續加強服務能力，為客戶提供可靠高效的技術支持。

研究與創新

作為一家技術驅動型公司，我們持續加強研發能力，並將技術創新視為長期增長的關鍵驅動力。通過完善研發管理與開發流程，我們增強了產品設計能力與技術服務，以滿足客戶不斷變化的需求。我們亦密切關注行業技術趨勢，透過持續的研發投入與內部技術積累，推動解決方案的不斷升級。此外，我們積極參與技術論壇、學術交流與行業研討會，加強與研究機構及行業夥伴的合作，促進知識共享，支持行業內的技術進步。

供應鏈管理

我們建立了涵蓋准入、績效評估、監督、審核及退出管理的生命周期供應商管理框架，並正逐步將ESG考量納入採購流程。在供應商准入階段，我們評估其質量保證能力、交付可靠性、合規表現以及環境與職業健康安全狀況。在合作期間，我們進行年度審核與績效評估，對發現不合規的情況要求整改，必要時暫停或終止合作。此外，順應行業趨勢與客戶期望，我們正逐步引入綠色電力使用、碳數據披露及可持續採購等實踐，以推動綠色、透明和可持續的供應鏈。

社區參與

我們重視履行企業社會責任，在穩健經營的同時積極參與社區活動。於往績記錄期間，我們向上海市慈善基金會浦東新區代表處主辦的慈善項目捐款，支持殘疾人人工智能訓練營，幫助提升其數字技能與科技應用能力。我們亦與浦東新區殘疾人黨群服務中心建立慈善合作關係，支持相關項目的持續開展。展望未來，我們將繼續透過志願服務和慈善合作，支持科技教育與社區公益，為社會可持續發展貢獻力量。

誠信與反舞弊

我們視誠信為企業管治的核心部分，並建立了全面的反舞弊及反貪污框架。我們已實施多項內部政策，包括《反賄賂反腐敗反舞弊管理制度》、《與客戶有關過程控制程序》、《採購控制程序》、《採購控制程序(生產性產品運營)》以及我們的員工行為守則，涵蓋採購、銷售、招投標及合作夥伴管理等關鍵領域。我們亦設立了專門的舉報渠道，包括電話和電子郵件，用於接收舉報，同時嚴格保護舉報人的保密資料。任何經查實的不當行為，均按嚴格的「零容忍」政策處理，並根據適用法律法規追究責任。

業 務

國際制裁及美國出口管制合規

我們的若干AI ASIC定制服務涉及使用若干原產於美國的軟件工具、IP及組件，因此須根據適用的美國出口管制法律接受評估。我們的國際制裁法律顧問審閱並顧及了設計該芯片時所使用的軟件，以及該芯片的性能水平、技術規格及用於該項目或為該項目提供的所有相關IP及技術資料。經分析後，國際制裁法律顧問認為，該等使用並未觸發適用國際制裁或美國出口管制法（包括美國的外國直接產品規則）項下的任何限制，且我們的活動於往績記錄期間並未涉及國際制裁項下的限制。此外，我們的若干供應商可能受限於貿易限制。例如，我們其中一家晶圓代工廠合作夥伴被列入美國出口管制清單。然而，我們的國際制裁法律顧問認為我們向其採購晶圓代工服務及材料並不違反適用美國出口管制規則，因為所涉及的物項不屬於該等規則的司法管轄範圍。

法律程序及合規

法律程序

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾亦並非任何重大法律、仲裁或行政程序的一方，且我們並不知悉有任何針對我們或我們的董事的未決或構成威脅的法律、仲裁或行政程序，而可能會個別或作為整體對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

合規

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾亦無捲入任何可導致罰款、執法行動或其他處罰的重大不合規事件，而該等事件可能會個別或作為整體對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

我們致力於通過建立並實施各類政策和程序（如全面風險管理程序）來培育合規文化，確保運營始終符合監管及合規要求。

社會保險及住房公積金供款

於往績記錄期間，經若干僱員同意，我們基於與相關僱員約定的金額繳納了社會保險，而非嚴格遵循中國法律法規的規定，主要由於僱員在參與社會福利計劃的程度方面存在個人偏好差異。截至最後實際可行日期，我們尚未完全補繳該等社會保險差額。於2023年、2024年及2025年，社會保險供款的差額分別為人民幣5.9百萬元、人民幣11.5百萬元及人民幣13.4百萬元。

於往績記錄期間，我們還聘請了第三方人力資源提供商為部分僱員繳納社會保險和住房公積金，因為該等僱員更傾向在其居住地（有別於簽立僱傭合約所在的城市）參加當地的社會保險和住房公積金計劃。於往績記錄期間，於2023年、2024年及2025年由第三方人力資源服務提供商作出的供款分別為人民幣4.3百萬元、人民幣6.9百萬元及人民幣7.8百萬元。根據中國法律法規，透過第三方賬戶繳納的社會保險及住房公積金供款可能被視為不完全合規。倘該等第三方安排受到中國主管機關質疑，或倘供款未能及時全額繳納，我們可能須補繳、支付滯納金或罰款，並可能面臨勞資糾紛。

業 務

根據中國法律法規，若未能按規定足額繳納社會保險費，社會保險費徵收機構可責令限期補足，並按日加收萬分之五的滯納金。逾期仍不繳納的，主管部門可進一步處以欠繳數額一倍以上三倍以下的罰款。

據我們的中國法律顧問所告知，基於以下理由，因未能足額繳納社會保險費而受到任何重大行政處罰的風險極低，前提是當前政策、法規及地方執法實踐無重大變化，且無重大員工投訴發生：

- (i) 我們已取得勞動和社會保險及住房公積金主管部門出具的相關證明，證明於往績記錄期間，我們未因違反勞動和社會保險或住房公積金相關法律法規而受到任何行政處罰；
- (ii) 主管當局在訪談中表示，在監管實踐中，若無員工投訴或舉報，其一般不會主動進行全面調查、作出處罰或要求追繳歷史社會保險供款，且任何投訴或舉報一般按個案基準處理；
- (iii) 根據於2018年10月10日發布的《國家稅務總局辦公廳關於穩妥有序做好社會保險費徵管有關工作的通知》(稅總辦發[2018]142號)，各地稅務局要遵循弄清接好歷史欠費賬目，不得自行組織開展清欠工作的原則，穩妥處理好歷史欠費問題。此外，稅務局應要規範執法檢查，不得自行組織開展以前年度的欠費清查；
- (iv) 截至最後實際可行日期，我們未收到任何關於社會保險和住房公積金供款的重大的員工投訴或監管通知，且在往績記錄期間，亦未因此捲入任何重大爭議或受到任何行政處罰；及
- (v) 若收到員工投訴或監管部門要求補繳的通知，我們將立即補繳社會保險的未繳差額。

基於上文所述，董事認為，有關社會保險及住房公積金供款的問題將不會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

請參閱「風險因素－與在我們營運所在司法權區經營業務有關的風險－未能遵守中國的社會保險及住房公積金法規可能使我們面臨罰款及其他法律或行政處罰」。

為確保完全遵守有關社會保險及住房公積金的所有法定要求，我們已主動啟動整改措施。我們位於上海、南京及無錫的附屬公司自2026年1月起已完全合規，且我們位於成都的附屬公司自2026年3月起已完全合規。此外，我們已制定一份全面的整改計劃，據此，我們將自2026年4月起直接為所有員工足額繳納社會保險及住房公積金。

業 務

此外，我們已實施以下內部控制措施以確保遵守政策及法規要求：

- 我們的人力資源部門將定期審查及更新我們的工資及僱員記錄，確保遵守最新中國法律法規計算及繳納所有供款；
- 我們的人力資源部門將密切監控有關社會保險及住房公積金的最新法規及政策，以防範進一步不合規情況；及
- 我們將對僱員及管理層團隊加強有關此方面中國法律法規的合規培訓。

內部控制與風險管理

在運營過程中，我們面臨多種風險。為此，我們制定了一套內部控制與風險管理政策及程序，以應對與業務相關的潛在運營、財務、法律及市場風險。我們定期審查這些程序以確保其有效性。相關政策程序涵蓋研發管理、銷售運營、採購執行、財務報告、信息披露管理以及信息技術的一般控制。

我們已指定專人負責監督本公司持續遵守規管我們業務運營的中國法律法規的情況，並監督必要措施的實施。此外，我們計劃為董事、高級管理層及相關僱員提供持續培訓計劃，並適時更新中國法律法規信息，以主動識別任何潛在不合規問題。

我們已制定內部規章政策，規範業務運營與管理的各個方面，包括信息系統、實物資產、採購、銷售與營銷、財務報告及人力資源。例如，我們針對信息管理系統設計並實施了一系列內部控制政策與程序，如設立專門團隊負責網絡安全與數據保護、制定數據保護政策及措施、為參與數據控制與管理的員工提供培訓。此外，我們已建立涵蓋人力資源管理各環節的內部控制政策，如招聘、培訓、職業道德及合規管理。同時針對財務報告管理制定了配套政策與程序，如財務會計政策、預算管理流程及財務報表編製程序。

於往績記錄期間，我們的董事未發現任何重大的內部控制缺陷或失效情況。我們亦已聘請獨立內部控制顧問就[編纂]事宜評估內部控制體系。內部控制顧問已對內部控制體系的若干方面（包括與財務報告相關的公司層面及流程層面內部控制）實施了審查程序。我們的內部控制顧問未發現內部控制體系存在任何重大內部控制缺陷或失效情況。

牌照、批准及許可

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已於所有重大方面從中國政府機構獲得業務運營所需的所有牌照、許可及批准，且這些牌照、許可及批准均保持完全有效。

下表載列我們的重要牌照、許可及批准清單。

牌照／許可／批准	持有人	授出機構	授出日期	屆滿日期
營業執照.....	本公司	北京經濟技術開發區市場監督管理局	2021年 2月1日	—

業 務

獎項及認可

憑藉我們的技術實力和可靠的服務，我們已建立起強大的品牌聲譽。

下表載列我們獲得的若干重大獎項及認可。

頒發年份	獎項／認可	頒發機構
2025年	2025中國AI芯片創新十強企業	世界集成電路協會(WICA)
2025年	國家標準GB/T 46280.1-2025 (芯粒互聯接口規範第1部分：總則)	國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會
2025年	國家標準GB/T 46280.2-2025 (芯粒互聯接口規範第2部分：協議層技術要求)	國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會
2025年	國家標準GB/T 46280.3-2025 (芯粒互聯接口規範第3部分：資料連結層技術要求)	國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會
2025年	國家標準GB/T 46280.4-2025 (芯粒互聯接口規範第4部分：基於2D封裝的實體層技術要求)	國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會
2025年	國家標準GB/T 46280.5-2025 芯粒互聯接口規範第5部分：基於2.5D封裝的實體層技術要求	國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會
2025年	2025中國AI基礎設施服務商商業落地Top20	億歐智庫
2025年	國家專精特新「小巨人」企業	中華人民共和國工業和信息化部
2025年	國家高新技術企業	江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳及國家稅務總局江蘇省稅務局

業 務

頒發年份	獎項／認可	頒發機構
2025年	2025中國AI半導體產業創新服務商TOP20	億歐創新者年會2025主委會
2025年	2024 VENTURE50新芽榜	清科控股有限公司旗下投資界
2024年	2024中國半導體企業影響力百強	世界集成電路協會(WICA)
2024年	2024中國半導體新銳企業Top20榜單	創新者年會2025主委會
2023年	江蘇省「雙創人才」	江蘇省組織部及江蘇省工信廳